

TIPLONews 한국어본

2023 년 11 월호(K291)

K231025Y1

01 Depo 와 Benz 간 특허권 소송 반전, 최고 법원은 지혜재산과 상업법원으로 반려.

대만 Depo¹⁾와 독일 Benz 간 특허권 침해 소송에서 Depo는 1심, 2심 모두 패소했었으나 대법원은 최근 2심 판결이 잘못됐다고 인정해 2심 판결을 파기하고 지혜재산 및 상업법원에 심리를 돌려보내는 판결을 내렸다. 이에 따라 Depo에게 역전승소의 기회가 주어지게 됐다.

Depo의 쉬수밍(許叙銘) 총재는 다음과 같이 말하였다: 계쟁 제품은 커버와 하우징의 구조에 대해 이미 우회 설계를 하였다. 고등법원은 Depo의 제품 외관에 대한 검증을 진행 중이라고 밝혔으나 대법원은 실제로 관련 절차가 진행되지 않았고 Depo에게 변론 기회가 주어지지 않아 절차상 하자나 오류가 있을 우려가 있음을 인정했다. 2심 판결에서 제품을 비교하며 문제되었던 「쌍동(雙瞳) - 두 눈동자」 같은 시각적 인상을 보이는지 여부에 대하여 Depo는 이미 「쌍동」에 대해 사실 증거에 제출하였기에 다시 조사해야 한다고 하였다.

Depo는 향후 해당 디자인이 무효이며 제품에 권리침해 사실과 공평교역법 위반이 없음을 증명하는 사실 증거를 제출해 Depo의 권익을 지키는 동시에 대만 자동차 관련 후속시장²⁾ 부품업계를 위해 목소리를 높여 당국이 연간 생산액 대만화폐 2200 억원 규모에 이르는 해당 산업을 중시하도록 계속 목소리를 내기로 하였다.

Benz는 2017년 Depo에 민사소송을 제기해 Depo 제품이 자신들의 대만 디자인 특허 제 D128047호 「차량의 헤드램프」 디자인 특허권을 침해했다고 주장했다. 2019년 Depo는 1심 패소 판결과 함께 침해 제품의 생산 금형을 폐기하라고 요구해 대만 자동차 부품업계가 발칵 뒤집혔었다. 2022년 7월 14일, 지혜재산 및 상업법원은 Depo가 지불해야 할 배상금을

대만화폐 3,000 만원에서 1,812 만원으로 낮추라는 2 심 판결을 내렸으나 여전히 침해 판결을 유지하였고, Depo 와 Benz 는 각각 항소를 제기하였다. 2023 년 10 월 4 일 대법원은 2 심 판결을 파기하여 본건을 지혜재산 및 상업법원으로 돌려보냈다. (2023.10)

역주:

- 1) 중국어명 帝寶工業股份有限公司, 영어명 Depo Auto Parts Ind. Co. Ltd. (Depo)
- 2) 후속시장은 원문의 AM (After Market)을 의역한 것임. 후속시장은 제품을 판매한 이후에 부품교체와 유지보수등을 해주는 서비스 시장을 말한다.



K231017Y1

K231017Z1

02 HTC 특허권 침해 인정 판결 대만화폐 2억8억원 상당 배상금 지급 판결

미국 델라웨어주 연방법원 배심원단은 HTC 가 룩셈부르크 특허 라이선스 회사인 3G 라이선싱 ¹⁾의 무선통신 특허를 침해했다며 미화 890 만 달러(약 대만화폐 2 억 8000 만원)가 넘는 배상금을 지급해야 한다고 판결했다. 3G 라이선싱은 수년전 HTC 와 특허 라이선스를 논의하다 협상이 결렬되자 2017 년 HTC 를 상대로 4G LTE 기술을 지원한 HTC 제품인 One, Bolt, Desire 등 여러 스마트폰에 대해 이 회사의 무선 표준 특허 2 건을 침해했다며 소송을 제기하고 무효를 주장했다.

미국 법원의 판결에 HTC 는 「우리회사는 배심원들의 노력에 감사하지만 이 사건의 판결에 실망했다. 이 판결은 당사의 업무에 중대한 영향을 미치지 않지만, 우리 회사의 권익을 지키기 위해 모든 상소 수단을 더욱 검토할 것」이라고 말했다. (2023.10)

역주:

1) 3G Licensing S.A 를 지칭.

Attorneys-at-Law

K231102Y5

03 국가 과학 및 기술위원회가 타 부서와 함께 「칩 주도형 대만 산업혁신 프로그램」을 제출

대만 행정원 국가과학 및 기술위원회는 2023 년 11 월 2 일 행정원 회의에서 「칩 주도형 대만 산업혁신 프로그램」¹⁾에 대해 보고하였다. 국가과학 및 기술위원회 ²⁾는 경제부, 교육부, 위생복지부, 농업부, 디지털발전부 ³⁾, 국가발전위원회 ⁴⁾와 함께 칩 주도형 대만 산업혁신 프로그램을 제출해 2024 년 과학기술 예산 대만화폐 120 억원을 계상했으며 향후 10 년간 (2024~2033 년) 대만화폐 3000 억원을 들여 추진할 계획이며, 제 1 기 (2024 년부터 5 년간)의 시동을 걸 예정이다.

「칩 주도형 대만 산업혁신 프로그램」은 「생성식 AI」와「칩」을 조합하여 획기적인 산업혁신을 촉진한다; 국내 인재육성 환경을 개선한다; 산업 혁신에 필요한 이질적 통합과 선진기술의 발전을 가속화한다; 해외 스타트업 기업과 투자를 유치한다는 4 가지 전략으로 대만의 미래 과학기술 산업을 위해 길을 열어, 산업이 가진 획기적 혁신 능력을 높이고 대만 과학기술력의 기초를 마련하여 세계에서 칩 설계에 관한 중요한 역할을 담당하는 것을 목표로 하고 있다. (2023.11)

역주:

- 1) 중국어명은 晶片驅動臺灣產業創新方案, 영어명은 Taiwan Chip-based Industrial Innovation Program
- 2) 중국어명은 國家科學及技術委員會
- 3) 중국어명은 數位發展部
- 4) 중국어명은 國家發展委員會